

## TZ-801 型自动探针测试台

高精度测试机型，适合于大管芯（ $\geq 1\text{mm}$ ），压焊点 $\geq 80\mu\text{m}$  半导体 IC、分立元件、非光敏元件的自动中测，与测试仪连接后，能自动完成管芯的精密电参数测试及功能测试。

### 主要技术特点：

1. 台式结构，平面电机气浮工作台
2. 支持测试仪及设备一体化（预留有集成空间）
3. 承片台光电闭环控制
4. 承片台采用镀金工艺，上下片过程具有芯片防磨损功能
5. 工作台无磨损、低噪声、长寿命、易维护
6. 可调分离针探头测试，探卡测试（可选）
7. 采用嵌入式专用工控机，集成专用运动控制器，15" LCD 显示器
8. I/O 系统配备了光电隔离转接盒
9. 电控系统增加了过流、过压、过热保护功能
10. 集成网卡，支持设备联网
11. Windows 友好界面，动态显示测试过程
12. 具备探高测试功能
13. 同步/延时/离线打点（任选）
14. 手动/自动测试任选
15. 自动测试方式灵活多样（单点、矩阵、探边、圆形、圆环、自定义编辑、抽测）
16. 具有 MAP 图显示和输出功能，配合软件可实现脱机观察
17. 公/英制步距（任选）



### 主要技术指标：

- 可测片径：3"、4"、5"、6"、8"
- 显微镜：14X~90X
- 工作台行程：460mm×220mm
- 工作台速度：200mm/s
- 步进分辨率：0.002mm
- 定位精度： $\leq 0.010\text{mm}$
- 重复精度： $\leq 0.003\text{mm}$
- 步距范围：0.002-200mm（公制） 0.000078"-7.8740"（英制）
  
- Z 向行程：0~6mm（可调）
- Z 向重复精度： $\pm 0.001\text{mm}$
- Z 向分辨率：0.002mm
- $\theta$  向调节范围： $\pm 15^\circ$



- 外形尺寸：（长×宽×高）1200mm×650mm×500mm
- 重量：约 200kg
- 功率：1kW
- 电源：AC 220V±22V,50Hz±1 Hz
- 气源：0.4~0.6MPa
- 真空：0.08MPa（用户自备）
  
- 使用温度环境：15°C-25°C
- 相对湿度：<70%
  
- 延时打点个数：1~7 个
- 测试仪接口：TTL、RS232、GPIB（488）其中 GPIB（488）为非标配，需另行订制
- 最多可布可调探头数：10 支、打点器 2 支、探边器 1 支